

单面抛光硅片激光划片镀铜硅激光挖槽刻槽打孔加工个性定制

产品名称	单面抛光硅片激光划片镀铜硅激光挖槽刻槽打孔加工个性定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

硅片激光切割工艺原理是利用高能激光束照射在工件表面，使被照射区域局部熔化、气化、从而实现硅材料的切割。硅片切割机主要用于金属材料及硅、锗、砷化镓和其他半导体衬底材料的划片和切割，可加工太阳能电池板、硅片、陶瓷片、铝箔片等，工件精细美观，切边光滑，可极大地提高加工效率和优化加工效果。

激光切割机在半导体晶片上的应用

半导体器件分类

激光属于非接触加工，不会对晶圆产生机械应力，对晶圆的损伤较小。由于激光聚焦的优势，聚焦点可以小到亚微米量级，更有利于晶圆的微加工，可以加工小零件。即使在低脉冲能量水平下，也可以获得高能量密度，并且可以有效地处理材料。大多数材料通过吸收激光直接蒸发材料，并冲出连续的盲孔形成通道。从而达到切割的目的，因为导光板小，碳化影响*低。

切割过程

半导体晶圆激光隐形切割技术是一种全新的激光切割工艺，具有切割速度快、切割时不产生粉尘、不损耗、要求、切割路径小、完全干法等诸多优点。隐形切割的主要原理是通过材料表面将短脉冲激光束聚焦在材料中间，然后通过外压将切屑分离